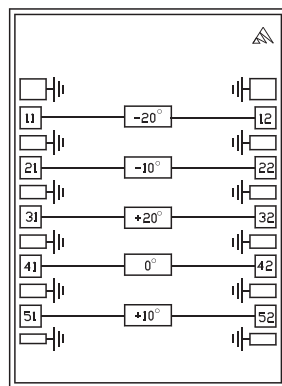


性能特点

- 工作频段：8~12GHz
- 四种可调相位： $\pm 10^\circ$ ， $\pm 20^\circ$
- 低插入损耗：0.2dB
- 低幅度波动： ± 0.1 dB
- 小回波损耗：-25 dB
- 芯片尺寸：1.33 x 1.74 x 0.1mm

功能框图



概述

BW339是一款调试用移相器芯片，尤其是在T/R多通道组件中，为保证通道间的相位一致性，有时候需要进行相位调节。该芯片工作频率覆盖X波段，在整个工作频段能提供 $\pm 10^\circ$ ， $\pm 20^\circ$ ，4种相位选择。BW339具有较高的移相精度，所有移相态的幅度波动 ± 0.1 dB。在应用频段内输入、输出端口匹配到50ohm，具有优良的输入、输出驻波。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

电性能表 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, 0/+5V控制, 50Ω system)

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	8	-	12	GHz
插入损耗	-	0.2	-	dB
输入回波损耗	-	25	-	dB
输出回波损耗	-	25	-	dB
相位误差 (中心频率)	-	± 1	-	deg
插入损耗波动	-	± 0.1	-	dB

极限参数

储存温度	-65~+175°C
工作温度	-55~+125°C
结温	175°C

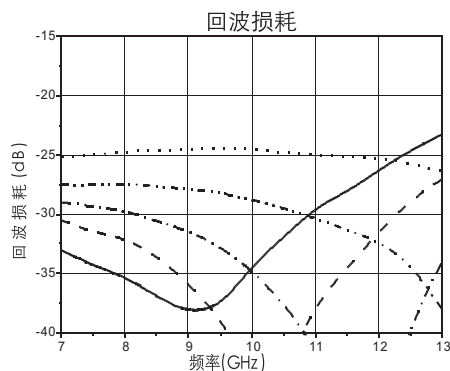
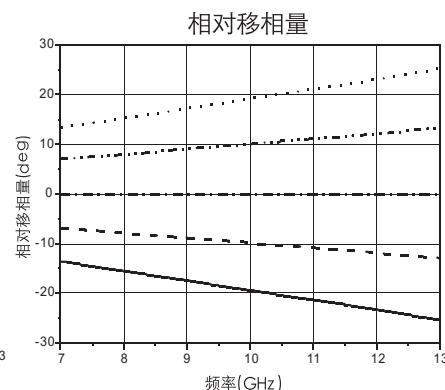
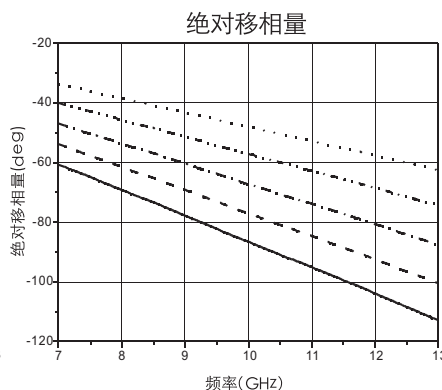
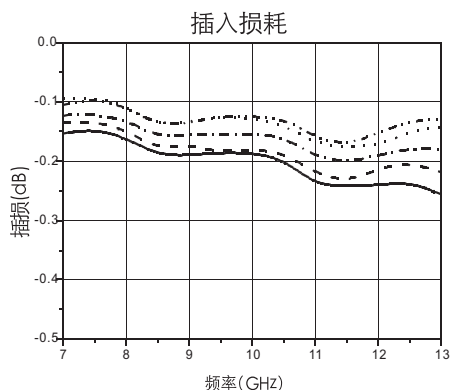


注意：高功率应用时，请采用共晶烧结工艺安装芯片。

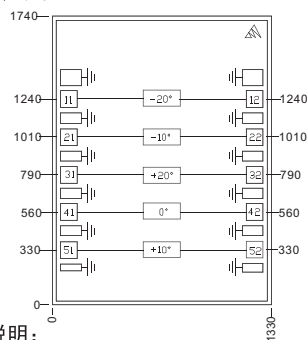
键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
11, 21, 31, 41, 51	RFin	RF输入端口, 阻抗50ohm
12, 22, 32, 42, 52	RFout	RF输出端口, 阻抗50ohm
-	GND	芯片背面必须接地

测试曲线 (裸芯片测试)



外形尺寸



说明:

1. 单位: 微米
2. 芯片背面镀金
3. 芯片背面接地
4. 键合压点镀金, 压点尺寸: 100x100μm
5. 不能在通孔上进行键合
6. 外形尺寸公差: $\pm 50\mu\text{m}$

应用信息

● 装配图

